

PCBレポート2020

2020年6月

〒103-0004 東京都中央区東日本橋2-24-12東日本橋榎町ビル8F-A

株式会社 ジャパンマーケティングサーベイ

TEL: 03-5829-3891 FAX: 03-5829-3892

E-mail: info@jms21.co.jp

<http://www.jms21.co.jp/>

調査内容

< 発刊主旨 >

近年PCB市場はスマートフォンの普及や自動車の電子化、ビッグデータ・クラウドによるサーバ市場の拡大等の影響から拡大基調を維持してきた。

当レポートはPCBのグローバルメカサプライヤの動向を詳細に調査・分析することによって、当該市場の現状と将来を網羅的に把握する上において好適なレポートとなる事を目的としている。

< 調査対象品目 >

- ◆PCB: 片面基板、両面基板、多層基板、ビルドアップ基板、ICパッケージ基板、FPC&R/F、その他
- ◆PCB用材料: 銅張積層板、銅箔、ドライフィルムレジスト、ソルダレジスト
- ◆PCB用製造装置: ダイレクトイメージング装置、レーザ穴開け装置、自動外観検査装置(AOI)、
ベアボードテスタ

※セラミックス基板及びテープパッケージ基板は、調査対象外とした。

※FPCには、アセンブリを含む。

< 調査のポイント >

- ◆PCB市場編: PCB市場規模(2019年)、PCB市場規模予測(基板種類別、応用分野別)、
PCB主要メーカーの販売動向(基板種類別、応用分野別)
- ◆PCB材料編: 主要メーカーの参入状況、生産拠点と生産能力、売上及び占有率、市場規模予測
- ◆PCB装置編: 主要メーカーが取り扱う製品、PCB用製造装置メーカーの市場規模予測
- ◆メーカー事例研究: 企業概要、生産拠点、生產品目、生産能力、販売実績

目次

項目	頁
総論	1
PCB市場概括(1)	2
PCB市場概括(2)	3
PCB市場概括(3)	5
第1章 PCB市場編	6
I. 2019年PCB市場規模概要	7
I. PCB市場規模(2019年)	8
II. PCBの市場規模予測	16
1. PCB種類別の市場規模予測	17
1.1 全体(金額ベース)	17
1.2 全体(数量ベース)	19
1.3 コンピュータ向け基板の種類別市場規模予測	21
1.4 通信機器(携帯端末)向け基板の種類別市場規模予測	23
1.5 通信機器(インフラ)向け基板の種類別市場規模予測	25
1.6 民生向け基板の種類別市場規模予測	27
1.7 自動車向け基板の種類別市場規模予測	29
1.8 産業、医療向け基板の種類別市場規模予測	31
1.9 軍需、航空向け基板の種類別市場規模予測	33
1.10 ICパッケージ基板の市場規模予測	35

目次

項目	頁
2. 応用分野別PCBの市場規模予測	36
2.1 全体	36
2.2 片面基板の応用分野別市場規模予測	38
2.3 両面基板の応用分野別市場規模予測	40
2.4 多層基板(4-10層)の応用分野別市場規模予測	42
2.5 多層基板(12-20層)の応用分野別市場規模予測	44
2.6 多層基板(22層以上)の応用分野別市場規模予測	46
2.7 ビルドアップ基板の応用分野別市場規模予測	48
2.8 ICパッケージ基板の市場規模予測	50
2.9 FPC&R/F基板の応用分野別市場規模予測	51
2.10 その他の応用分野別市場規模予測	53
III. PCB主要メーカーの販売動向	55
1. PCBメーカーの基板種類別の販売実績	56
1.1 全体(2019年)	56
1.2 コンピュータ向け基板の販売実績(2019年)	59
1.3 通信機器(携帯端末)向け基板の販売実績(2019年)	62
1.4 通信機器(インフラ)向け基板の販売実績(2019年)	65
1.5 民生向け基板の販売実績(2019年)	68
1.6 自動車向け基板の販売実績(2019年)	71

目次

項目	頁
1.7 産業、医療向け基板の販売実績(2019年)	74
1.8 軍需、航空向け基板の販売実績(2019年)	77
1.9 ICパッケージ基板の販売実績(2019年)	80
2. PCBメーカーの応用分野別の販売実績	83
2.1 全体(2019年)	83
2.2 片面基板の応用分野別の販売実績(2019年)	85
2.3 両面基板の応用分野別の販売実績(2019年)	88
2.4 多層基板全体の応用分野別の販売実績(2019年)	91
2.5 多層基板(4-10層)の応用分野別の販売実績(2019年)	94
2.6 多層基板(12-20層)の応用分野別の販売実績(2019年)	97
2.7 多層基板(22層以上)の応用分野別の販売実績(2019年)	100
2.8 ビルドアップ基板の応用分野別の販売実績(2019年)	103
2.9 ICパッケージ基板の販売実績(2019年)	108
2.10 FPC & R/F基板の応用分野別の販売実績(2019年)	110
2.11 その他の応用分野別の販売実績(2019年)	113
第2章 PCB材料編	116
1. 銅張積層板	117
1.1 銅張積層板の分類と概要	117
1.2 主要メーカーの生産拠点と生産能力	118

目次

項目	頁
1.3 主要メーカーの売上及び占有率(2019年)	123
1.4 銅張積層板の市場規模予測	126
2. 銅箔	127
2.1 主要メーカーの参入状況	127
2.2 主要メーカーの生産拠点と生産能力	128
2.3 主要メーカーの売上及び占有率(2019年)	130
2.4 銅箔市場規模予測	132
3. ドライフィルムレジスト	133
3.1 主要メーカーの取扱い製品のタイプ	133
3.2 主要メーカーの生産拠点と生産能力	134
3.3 主要メーカーの売上及び占有率(2019年)	135
3.4 ドライフィルムレジスト市場規模予測	137
3.5 主要メーカーの事業動向	138
4. ソルダレジスト	139
4.1 主要メーカーの参入状況	139
4.2 主要メーカーの生産拠点と生産能力	140
4.3 主要メーカーの売上及び占有率(2019年)	141
4.4 ソルダレジスト市場規模予測	143
第3章 PCB装置編	144

目次

項目	頁
1. ダイレクトイメージング装置	145
1.1 主要機種一覧	145
1.2 ダイレクトイメージング装置市場規模予測	146
2. レーザ穴開け装置	147
2.1 製品外観	147
2.2 主要機種一覧	149
2.3 レーザ穴開け装置市場規模予測	150
3. 自動外観検査装置(AOI)	152
3.1 主要機種一覧	152
3.2 自動外観検査装置(AOI)市場規模予測	153
4. ベアボードテスト	154
4.1 主要機種一覧	154
4.2 ベアボードテスト市場規模予測	155
第4章 PCBメーカー事例研究	157
<日本メーカー>	158
NIPPON MEKTRON, LTD.	159
IBIDEN CO., LTD.	162
MEIKO ELECTRONICS CO., Ltd.	165
Fujikura LTD.	169

目次

項 目	頁
CMK CORPORATION	172
SUMITOMO ELECTRIC PRINTED CIRCUITS INC.	177
SHINKO ELECTRONIC INDUSTRIES CO., LTD.	180
Kyoden Co., Ltd.	183
KYOCERA Corporation	187
<台湾メーカー>	190
Zhen Ding Technology Holding Limited	191
Unimicron Technology Corporation	195
Tripod Technology Corporation	199
Compeq Manufacturing Co. Ltd.	203
WUS Printed Circuit Co., Ltd.	207
HannStar Board Co., Ltd.	210
Nan Ya Printed Circuit Board Corporation	214
Unitech Printed Circuit Board Corporation	217
Taiwan PCB Techvest Co., Ltd.	221
Gold Circuit Electronics Ltd.	224
Chin Poon Industrial Co., Ltd.	228
<韓国メーカー>	231
Young Poong Group	232

目次

項目	頁
Samsung Electro-Mechanics Co., Ltd.	235
Daeduck Electronic Co., Ltd.	239
Simmtech Co., Ltd.	242
ISU Petasys Co., Ltd.	245
LG Innotek Ltd.	248
DAP CORPORATION	250
<中国メーカー>	252
Suzhou Dongshan Precision Manufacturing Co., Ltd.	253
Shennan Circuits Co., Ltd.	256
Kingboard Holdings Limited	259
Shenzhen Kinwong Electronic co., Ltd.	263
Guangdong Ellington Electronics Technology Co., Ltd.	266
<その他メーカー>	269
TTM technologies, Inc.	270
AT & S Austria Technologie & Systemtechnik Aktiengesellschaft	273

レポートの概要及び申込み要項

< 発刊日・頁数・価格 >

- ◆ 発刊日: 2020年6月1日
- ◆ 体裁: A4判 / 276頁
- ◆ 価格(税込): 275,000円(レポート本体)、308,000円(レポート本体+CD)

< 申込要項 >

▼ 申込方法:

巻末の申込書に所定事項をご記入の上、弊社宛までFAXもしくは電子メールにて送信お願いいたします。

* メール(info@jms21.co.jp)にて申込必要事項(申込レポート名、申込形態、企業名、担当者所属/名前、住所、電話、E-mail)を連絡ください。

* ホームページのレポートのお申し込みから、必要事項を入力・送信お願いいたします。

▼ お支払方法について:

予約申込時に請求書を発行いたしますので、請求日の翌月末までに弊社指定口座にお振込みお願い申し上げます。

▼ 調査資料のお取り扱いについて

調査資料(レポート)のデータについては、ご契約頂いた同一法人内にその利用範囲を限定させていただきます。また、第三者への譲渡、複写を禁止いたします。

※ 外部向けプレゼンテーション資料として一部データのご使用については、この限りではございませんので、ご相談ください。

申込書

JMS

年 月 日

株式会社ジャパンマーケティングサーベイ 行 (Fax:03-5829-3892)

調査レポート：PCBレポート2020

レポート本体のみ購入：¥275,000- (税込)

レポート本体+CD購入：¥308,000- (税込)

※前項の調査資料の取扱いについて同意の上、レポートの購入を申し込みます(要)

申込企業名： _____

申込者： _____

所属： _____ 役職： _____

TEL： _____ Email： _____

所在地： (〒 _____)

連絡事項等：